산업통상자원부	보도참고자료	다시 도약하는 대한민국 함께 잘사는 국민의 나라	

보도 일시	2023. 3. 22.(수) 10:30	배포 일시	2023. 3. 22.(수)
담당 부서	첨단산업정책관 반도체과	책임자	과 장 이규봉 (044-203-4270)
		담당자	서기관 차세운 (044-203-4271)
	통상정책국 미주통상과	책임자	과 장 이승헌 (044-203-5650)
		담당자	사무관 윤경민 (044-203-5658)

미국, 반도체지원법「가드레일 조항」세부규정(안) 발표

- 우리 기업의 중국내(內) 설비 부분 확장과 기술 향상(업그레이드) 가능 -

- 정부, 우리 기업과 소통하면서 미국 정부와 긴밀히 협의해 왔으며, 앞으로도 지속 협의해 나갈 것 -

□ 산업통상자원부(장관 이창양)는 3월 21일(화) 21시45분(한국시간) 美 정부에서 **미국 반도체지원법***상 투자 인센티브를 수령하는 기업의 **중국** 등 **“우려대상국”** 내 **설비확장을 제한**하는 **“가드레일 조항”의 세부규정 초안**을 발표했다고 밝혔다.

* CHIPS and Science Act (`22.8월 발효) : 반도체 산업에 대한 재정지원 527억불 (시설투자 인센티브 390억불 포함), 투자세액공제 25% 등을 규정

** 우려대상국(foreign country of concern) : 중국, 북한, 러시아, 이란

< 우리 업계에의 영향 >

□ 금번 발표된 가드레일 세부 규정을 검토한 결과, 우리 기업이 중국에서 운영하고 있는 <u>생산 설비의 유지 및 부분적 확장은 물론 기술 업그레이드도 계속 가능할 것</u>으로 판단되며,

○ 기술 업그레이드 시, 집적도 증가를 통해 웨이퍼당 칩을 증가시킬 수 있어, 기업 전략에 따라서는 추가적인 생산 확대도 가능할 것으로 예상된다.

□ 정부는 **업계와 계속 소통하면서** 세부 규정의 내용을 **상세히 분석**할 것이며,

○ 동 분석결과를 토대로 **60일간의 의견수렴 기간** 동안 **미측과 추가적인 협의를 진행**해나갈 예정이다.

□ 우리 기업은 가드레일 세부규정 등 관련된 제반 여건을 분석, **글로벌 경영 전략 차원**에서 對美 투자 및 美 인센티브 신청 등과 관련한 **의사결정을 내릴 것으로 예상**되며, **정부는 이러한 기업의 전략적 선택을 총력 지원**할 계획이다.

< 對美 협의 경과 >

□ 우리 정부는 미국 반도체지원법의 **발효(`22.8월) 직후**, 미측에게 가드레일 조항 관련 양국간 **긴밀한 협의와 발표전 사전 협의를 요청**한 바 있다.

* 美 상무장관 앞 서한 발송(`22.8), 한미 산업장관 회담(`22.9) 등

○ 이후, 각급에서 미측과의 협의*를 진행하는 등 한미 양국은 **가드레일 세부규정 마련 과정에서 지속적으로 협의**해 왔으며,

* 첨단산업정책관(1월), 1차관(2월), 통상교섭본부장(3월) 등 訪美협의 실시

○ 동 세부규정의 대외공개 전, 美 정부로부터 **세부 규정의 주요 내용에 관한 브리핑**을 받는 등 양국간 긴밀한 소통을 계속해 왔다.

□ 우리 기업이 對美 투자를 원활하게 진행하고 美 반도체지원법상의 지원을 충분히 제공받을 수 있도록 **미국 정부와 협의를 지속**해 나갈 예정이며,

○ 특히, 오는 **3.23일에 방한**하는 **美 반도체지원법 담당 주요 실무진**과 **재정 인센티브의 세부 지원계획(NOFO)*** 및 **가드레일 세부규정** 등에 대해 협의할 예정이다.

* 재정지원공고(Notice of Funding Opportunity)

< 향후 계획 >

□ 美 정부는 금번에 발표한 가드레일 세부규정 초안에 대해 **60일간의 의견수렴**을 거친 후 규정을 최종 확정할 예정으로,

○ 동 의견수렴기간 동안 우리 정부는 업계와의 소통을 거쳐 우리측 관심사안에 대해 미측과 협의를 진행할 계획이다.

□ 또한, 지난 2.28일 발표되었던 美 반도체지원법 **재정 인센티브의 세부 지원계획(NOFO)**, 미국의 **對중국 반도체장비 수출통제** 등 주요 현안이 우리 반도체업계에 미치는 **불확실성·부담을 최소화**하기 위해, 美 상무부 등 관련 당국과의 협의에 만전을 기할 계획이다.

□ 한편, 해외 투자·경영 환경의 불확실성*이 커지고 글로벌 경쟁이 치열해지는 등 **반도체 산업 여건이 갈수록 엄중**해지는 상황에서는 대외 통상 현안의 관리와 더불어, 우리 기업이 활용 가능한 **국내 생산·투자 기지 확충**, 산업경쟁력 강화 등을 위한 **전략적 대응도 절실**한 상황이다.

* (중국) 對중국 장비규제 등으로 중국을 생산기지로 활용할 때의 불확실성 점증
* (미국) 對美 투자시의 부가 조건, 투자비용 및 인력여건 등에 대한 종합적 고려 필요

○ 이에, 정부는 금번에 발표된 세계 최대의 **시스템반도체 클러스터 신규 조성***을 포함, 국내 **반도체 메가 클러스터 구축****을 위한 전략을 관계부처 협업 하에 차질없이 추진하는 한편,

* `42년까지 300조원 규모 투자, 단일 단지 기준 세계 최대 규모 (경기도 내 조성)
** 신규 클러스터와 기존 생산단지(기흥·화성·평택·이천 등) 및 인근 소부장기업, 팹리스밸리(판교) 등 연계

○ 상대적으로 취약한 **시스템반도체의 생태계 강화**를 위한 정책에도 전력을 다할 계획이다.

* 설계-제조-후공정 등 시스템반도체 생태계 전반의 업그레이드, 세제 및 재정, 인력 지원 등을 통한 산업성장 기반 강화, 차세대반도체 핵심 기술개발 지원 등

< 미측 발표 내용 >

□ 미국 반도체지원법상 투자 인센티브를 수령하는 기업(이하 "수혜기업")은 중국 등 우려대상국 내에서의 **설비 확장** 및 **기술 협력**을 **다음과 같이 제한**받게 되며, 동 의무를 위반할 경우 美 정부에서 해당 인센티브를 환수할 수 있다.

□ (**설비확장 제한**) 수혜기업은 **중국** 등 우려대상국에 있는 **생산설비의 생산능력***을 **10년간 5% 이내로 확장 가능**하며,

* 이 때 반도체 前공정 제조설비(Fab)의 생산능력은 **웨이퍼**를 기준으로 측정

○ 일정 사양 이하인 "**레거시" 반도체*** 생산설비인 경우, 기존 설비의 생산능력 확장을 **10년간 10% 미만까지**는 허용하고 있다.

* 레거시반도체 : (로직칩) 28nm 이상, (메모리) 낸드 128단 미만, D램 18nm 초과
(메모리는 `22.10월 발표된 미국의 대중국 반도체장비 수출통제 기준점과 동일)

○ 한편, 금번 발표된 세부규정에서는 중국 등 우려대상국 내 **생산설비의 기술·공정 업그레이드를 위한 투자**, 기존 설비의 운영에 필요한 장비 교체 등의 투자에 대한 **제한을 두지 않고 있어**,

- 5%(또는 10%) 설비확장 상한 내에서 對중국 반도체장비 수출통제 규정을 준수할 경우 **중국 생산설비의 기술·공정 업그레이드를 계속 진행**할 수 있게 되었다.

□ (**기술협력 제한**) 수혜기업은 우려대상기관*과의 국가안보상 민감한 기술·품목**과 관련된 공동 연구 및 기술 라이센싱을 제한받게 된다.

* 우려대상기관(foreign entity of concern) : 우려대상국의 관할권 내에 있는 기업, 미국 제재 대상 기관 등을 포함

** 국가안보상 중요 반도체(화합물 반도체, 나노소재 활용 반도체 등), 국가안보·지역안정성을 이유로 통제되고 있는 수출통제목록(Commerce Control List) Category 3 품목 등